

Application Note

电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析



Gerard Copeland

摘要

本应用报告研究了印刷电路板 (PCB) 布局对低压降 (LDO) 稳压器热性能的影响，特别是结至环境热阻 θ_{JA} 。此参数是针对 TPS745 (WSON 封装) 、TPS7B82-Q1 (TO-252 封装) 和 TLV755P (SOT-23 封装) 器件测量的。每款器件均在五种布局下进行测试，这五种布局的内层与外层铜覆盖率依次递增。增加铜覆盖量会降低 θ_{JA} ，但这种改善效果会达到一个收益递减的临界点。铜覆盖对于具有散热焊盘的封装更有效。这些结果旨在为系统设计人员提供布局技巧，从而提高热性能。尽管本研究测试的器件仅为 LDO，但报告中关于 PCB 布局的影响分析及结论，同样适用于其他存在功耗的器件。

内容

1 简介	2
2 过程	6
3 测试结果与讨论	7
4 结语	11
5 未来研究方向	11
6 参考资料	11
7 修订历史记录	12
A 热测试电路板布局	13
A.1 TPS745 (WSON) 图	13
A.2 TPS7B82-Q1 (TO-252) 图	18
A.3 TLV755P (SOT-23) 图	23
B 热测试结果	28
B.1 热性能数据	28

商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 简介

LDO 具有相对简单性和成本优势，因此是电子电源设计中最常见的 DC/DC 转换器。随着应用日益集成化与小型化，电源设计需向更小尺寸、更低成本方向发展，这导致 LDO 的使用量不断增加。由于 LDO 属于线性转换器，本身存在功耗，因此热性能成为系统设计中愈发重要的考量因素。尽管 JEDEC 已制定了半导体热性能参数的统一测量与报告标准，但该标准在热性能优化方面尚未完善。影响热性能的最重要因素之一在于系统设计人员，即 PCB 布局。本应用报告旨在研究 PCB 布局对 LDO 热性能的影响，为设计人员提供参考。尽管此前已有 [《采用小型 SMD 封装的 LDO 热性能》应用报告](#) 和 [《AN-1520 确保外露封装实现出色热阻的电路板布局布线指南》应用报告](#) 探讨过该主题，但本研究通过在功能性场景下采集数据，力求提升结论的实用性。该设置包括带有无源器件（模拟 TI 评估模块 (EVM)）的功能 PCB 布局以及通过有源供电进行的热性能测量。有源供电是指将 LDO 置于正常工作状态，并通过改变输入电压与负载电流来增加器件功耗，使器件结区产生热量。

评估半导体热性能最常用的参数是结到环境热阻 θ_{JA} 。[方程式 1](#) 显示，该参数定义为器件每消耗 1 瓦功率时，器件工作温度与结温差值，公式如下：

$$\theta_{JA} = \frac{T_J - T_A}{P_D} \quad (1)$$

在特定功耗水平下，设计中 θ_{JA} 越小，器件结温越低，从而可提升器件寿命与可靠性。[《半导体和 IC 封装热指标》应用报告](#) 指出，对 θ_{JA} 影响较大的两个因素是 PCB 布局与 IC 封装。TPS745 (WSON 封装)、TPS7B82-Q1 (TO-252 封装) 和 TLV755P (SOT-23 封装) 三款 LDO 采用五种不同的 PCB 布局进行了测试，以探究上述两个因素对热性能的影响程度。

半导体热性能受气流、海拔、环境温度等多种外部因素影响，因此 JEDEC 需针对 θ_{JA} 和其他热指标制定标准化的测量流程与测试板。为了完成本应用报告的测试，针对每种封装设计了两类测试板布局，即 <https://www.jedec.org/system/files/docs/JESD51-3.PDF> 中介绍的低效导热性测试板的近似布局和 <https://www.jedec.org/system/files/docs/jesd51-7.PDF> 中介绍的高有效导热性测试板的近似布局，除此之外，还额外设计了三种定制化布局。每块电路板的面积与层叠结构均遵循 JEDEC 标准测试板近似布局：4 层 PCB，面积为 9in² (3 英寸 x 3 英寸)。外层铜箔厚度为 2 盎司，内层铜箔厚度为 1 盎司。为每种封装制作的五种布局中，与器件相连的铜箔量逐渐增加，此举旨在测量结到环境热阻 θ_{JA} ，并验证其与铜箔覆盖率之间的反比关系。为提高三款封装测试结果的一致性，每种布局中用于散热的铜箔量均保持一致。按铜箔含量从低到高排序，这些布局类型分别命名为：

- 1S0P 近似布局
- 内部断开布局
- JEDEC 高 K 近似布局
- 热增强型
- 热饱和型

根据 <https://www.jedec.org/system/files/docs/JESD51-9.pdf> 中规定的 JEDEC 标准，所有 WSON 和 TO-252 布局的散热焊盘处均设有散热过孔。这些散热过孔的直径为 20 毫米 (mm)，孔径为 10 毫米，铜镀层厚度为 17 微米。

选用两个不同的 θ_{JA} 值作为比较基准。第一种是 $\theta_{JA, datasheet}$ ，该值以 $R_{\theta, JA}$ 形式标注在各器件数据手册的“热信息”表格中。 $\theta_{JA, datasheet}$ 通过 JEDEC 高 K 热量测试板的热模型推导得出，是设计人员评估热性能最常用的参数。第二个值为 $\theta_{JA,1S0P}$ ，该值通过 1S0P 近似布局实测得出。此值提供了最坏情况布局的预期热性能示例。

图 1-1 至图 1-5 显示了为采用 WSON 封装的 TPS745 设计的每个布局所生成的 3D 图像。每种布局的四层板结构图可参见附录 A。[表 1-1](#) 提供了每种设计布局和覆铜的说明。

表 1-1. 布局标识与说明

电路板	属性	说明	连接的铜面积 (in ²)	断开的铜面积 (in ²)
1SOP 近似布局	顶层	仅走线	无	无
	内层 1	无铜		
	内层 2	无铜		
	底层	仅走线		
	额外的散热过孔	无		
内部断开布局	顶层	仅走线	0.07	16.8
	内层 1	中等面积、未连接、不连续的铜平面 ⁽¹⁾		
	内层 2	中等面积、未连接、不连续的铜平面 ⁽¹⁾		
	底层	走线及一个小型接地平面		
	额外的散热过孔	无		
JEDEC 高 K 近似布局	顶层	仅走线	10.2	8.53
	内层 1	一个较大的接地平面		
	内层 2	走线和一个大的未连接平面		
	底层	一个中等接地平面		
	额外的散热过孔	无		
热增强型	顶层	走线及一个小型接地平面	10.5	8.43
	内层 1	小型接地平面及两个未连接铜平面		
	内层 2	走线及一个中型接地平面		
	底层	一个中等接地平面		
	额外的散热过孔	仅器件周围		
热饱和型	顶层	大型接地平面及电源平面	34.1	无
	内层 1	一个较大的接地平面		
	内层 2	走线及一个大型接地平面		
	底层	一个较大的接地平面		
	额外的散热过孔	器件周围和整个 PCB		

(1) 旨在模拟无专用接地平面的高密度应用场景。

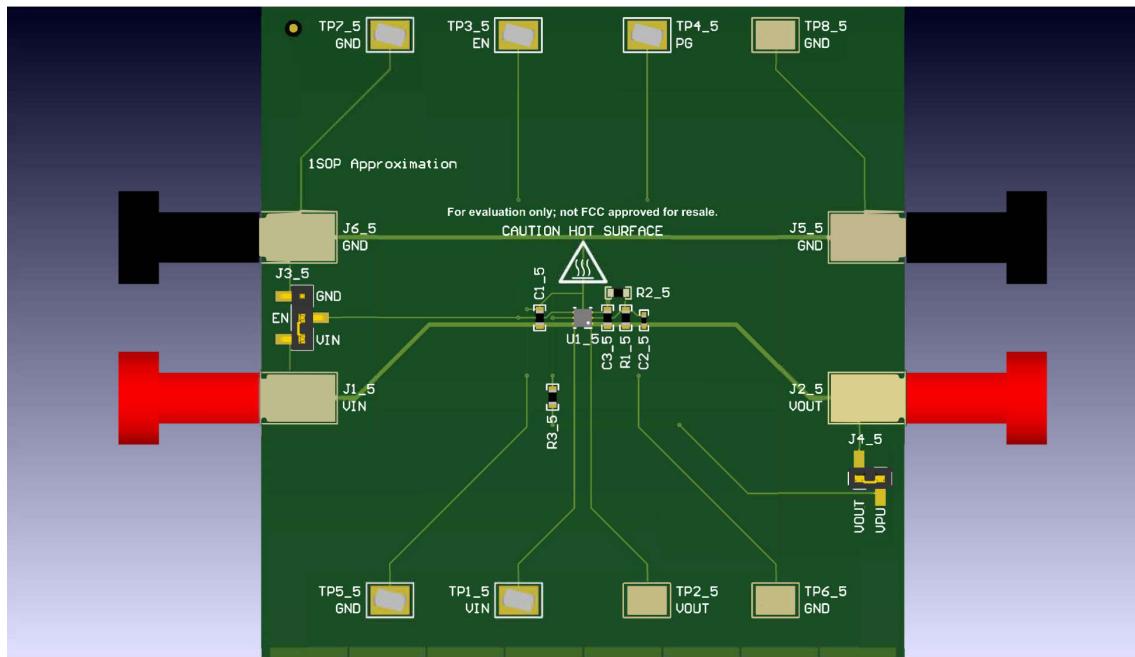


图 1-1. TPS745 (WSON) 1SOP 近似布局

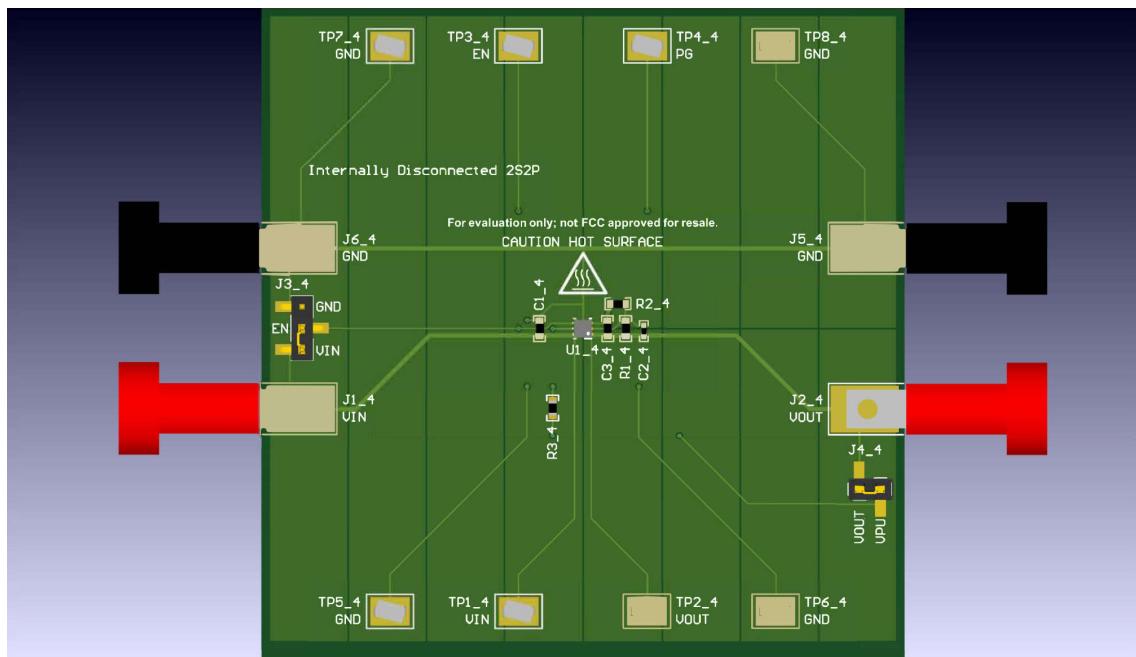


图 1-2. TPS745 (WSON) 内部断开布局

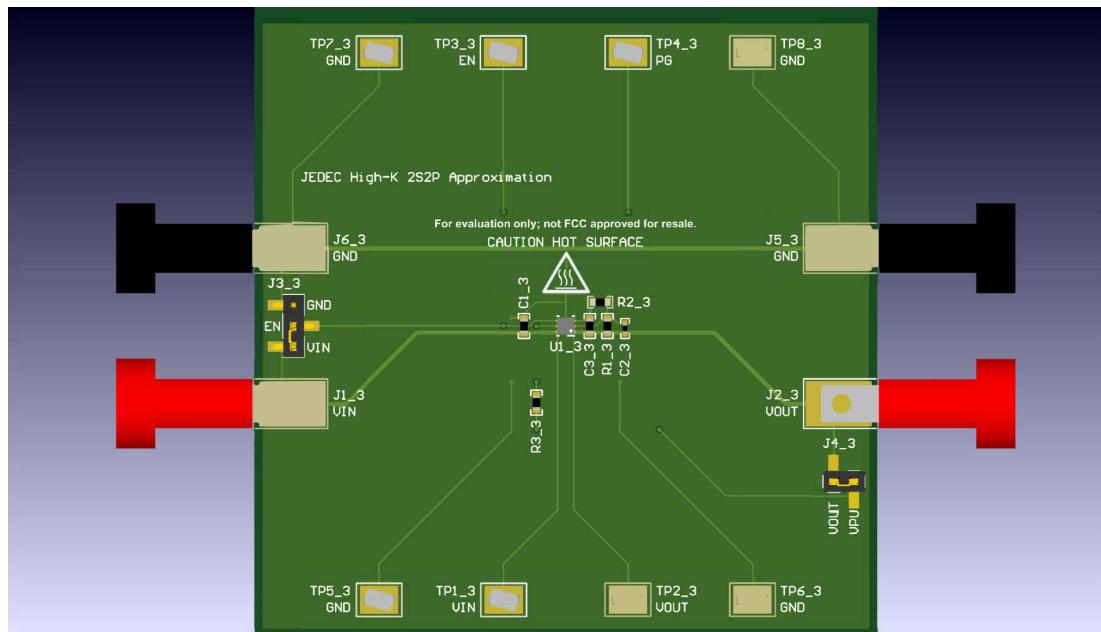


图 1-3. TPS745 (WSON) JEDEC 高 K 近似布局

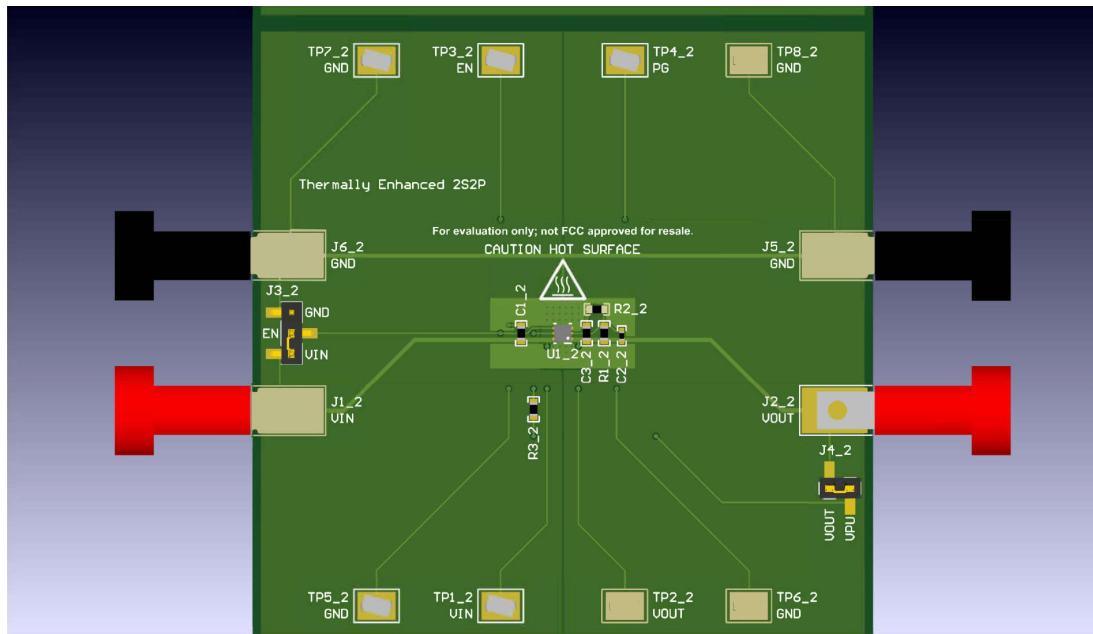


图 1-4. TPS745 (WSON) 热增强型布局

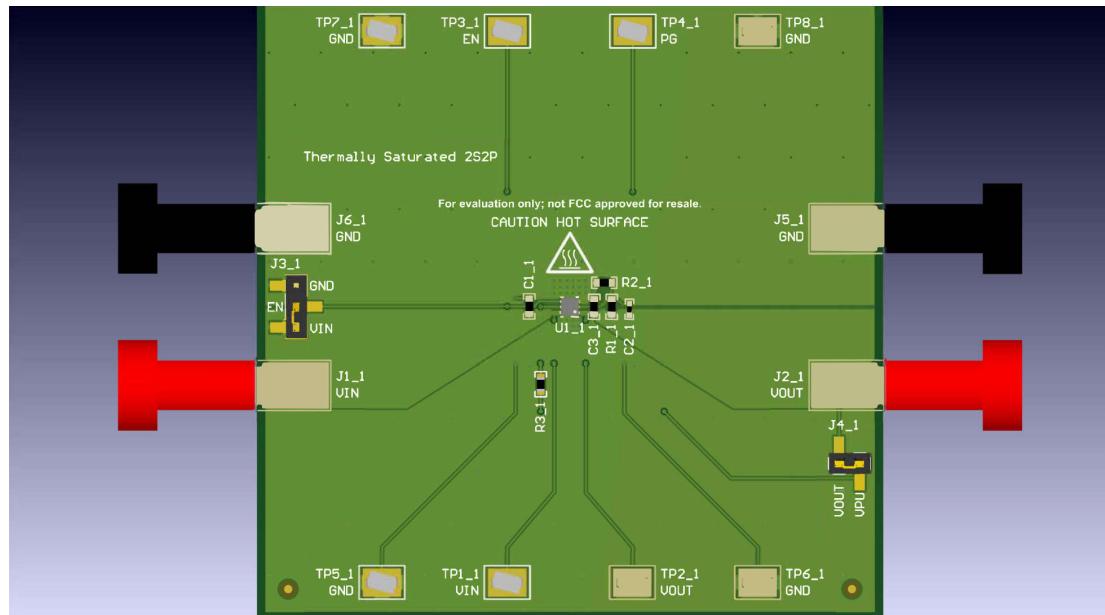


图 1-5. TPS745 (WSON) 热饱和型布局

2 过程

大多数现代 LDO 均具备热关断功能，可防止器件在高结温下遭受严重损坏。在特定功耗水平下，带有热关断功能的 LDO 存在最高工作环境温度阈值，可触发热关断，器件随即停止工作。方程式 2 展示了用热关断温度替代结温的过程，以及对公式方程式 1 的推导整理：

$$T_{A,max} = T_{SD} - \theta_{JA} \times P_D \quad (2)$$

《现场测量 LDO 热阻抗》应用报告说明，该公式提供了一种无需直接接触器件结区即可测得结到环境热阻 θ_{JA} 的方法。首先，选择较低的功耗值，使此时器件的最高工作环境温度基本等于其热关断温度。使用高温烘箱设定环境温度，并让 LDO 在该温度下恒温放置 5 分钟。随后需关闭高温烘箱以停止气流流动，因 JEDEC 标准模型默认无强制对流条件。接着使用示波器监测 LDO 是否关闭输出。若出现输出停止的情况，表明热关断功能已被触发。如果 LDO 未进入热关断状态，则升高环境温度并重复上述流程，直至确定最高工作环境温度。针对逐步升高的不同功耗水平重复上述流程，以便在使用公式方程式 2 计算 θ_{JA} 时获得足够数据用于线性回归分析。

该流程的测量精度存在一定局限性，因测量过程中环境温度与功耗易发生变化。为确保自然对流而关闭高温烘箱，会导致环境温度逐渐下降。同时，高温烘箱产生的对流冷却效应消失，会导致器件结温升高。由于 LDO 基准带隙随温度漂移，其输出电压会降低，进而导致传输晶体管的功耗增加。高温烘箱的测量精度通常为 $\pm 2^\circ\text{C}$ ，这也会降低测得的 θ_{JA} 的准确性，为解决这些局限性，必须选择大范围的功耗水平，以覆盖宽泛的最高环境温度区间。方程式 2 显示 θ_{JA} 定义为这两个变量之间趋势线的斜率。因此，验证温度与功耗在宽范围内保持线性关系可以提高 θ_{JA} 测量的可信度。

该流程的主要优势在于相对简单。由于无需对 PCB 或 LDO 进行改装即可测量特定电路板温度或结温，该流程可用于任意电路板的 θ_{JA} 测量；尽管精度略有损失，但能提供更贴近实际应用的 PCB 布局与测试环境，对系统设计人员更具参考价值。鉴于本应用报告的目标是通过研究多封装下 PCB 布局与热性能的普遍趋势为设计人员提供参考，因此优先构建贴近实际应用的测试环境。

3 测试结果与讨论

图 3-1 展示了 1S0P 近似布局下，TPS745 (WSON 封装) 的最高环境温度与功率耗散间的关系。趋势线的斜率表明 θ_{JA} 为 169.2 C/W。所收集数据的范围和线性度支持方程式 2 中所述的 LDO 功率耗散与最高工作环境温度之间的预期关系。

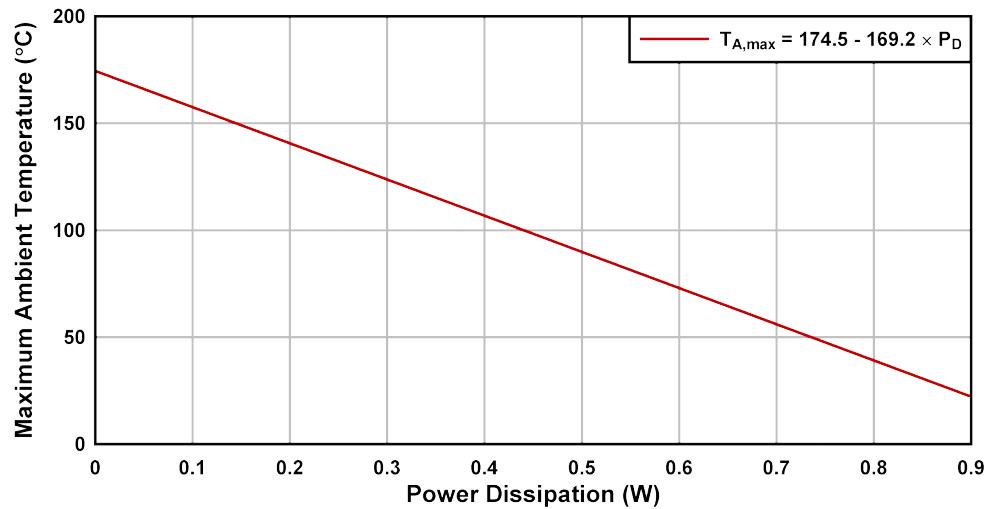


图 3-1. TPS745 (WSON) 1S0P 近似布局测试结果

所有封装与布局的同类数据可参见附录 B。图 3-2 和图 3-3 分别给出了 TPS745 (WSON) 和 TPS7B82-Q1 (TO-252) 的 θ_{JA} 实测值。在全部五种布局下，这两款封装的热性能呈现出相似趋势。尽管仅连接的铜面积为 0.07 in²，但内部断开的布局仍可将 θ_{JA} 降低近 50%，这表明，即使内层铜箔未直接与 LDO 相连，在内部层增加铜箔也能显著提升热性能。剩下的布局中，随着铜用量和散热过孔数量逐渐增加， θ_{JA} 会持续下降但降幅渐小，最终最大降幅略超 70%。基于所采集的数据，高效热布局对于 WSON 与 TO-252 封装至关重要。如果布局热效率低下， θ_{JA} 会显著高于数据手册规定值，进而导致热性能计算更为复杂、最高工作环境温度降低，并可能导致器件寿命与可靠性下降。

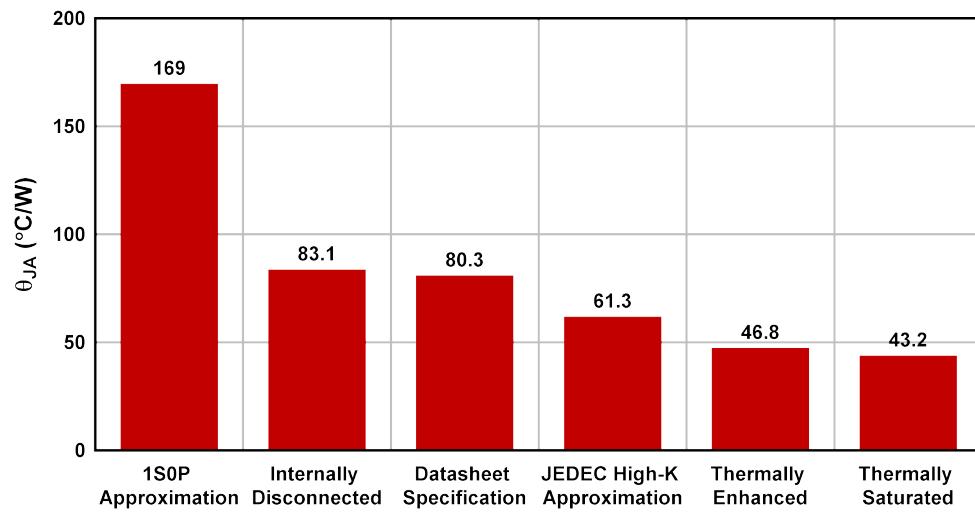


图 3-2. TPS745 (WSON) θ_{JA} 与电路板布局间的关系

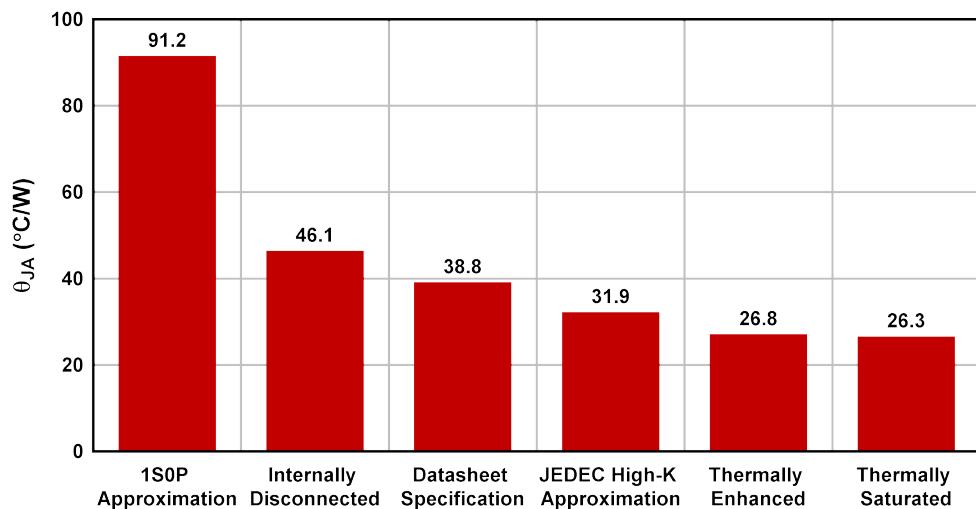
图 3-3. TPS7B82-Q1 (TO-252) θ_{JA} 与电路板布局间的关系

图 3-4 显示了 TLV755P (SOT-23) 的 θ_{JA} 实测值。SOT-23 封装的 θ_{JA} 存在差异，原因是该封装无散热焊盘。JEDEC 标准不允许在高 K 热测试板上为没有散热焊盘的封装添加散热过孔。少量热量能够消散到内层和底层，因此 1SOP 近似布局与 JEDEC 高 K 测试板的热模型（数据手册规格即源于此模型）之间的性能非常相似。为避免多种不同布局呈现完全一致的性能，器件下方的内部断开布局中增设了一个散热过孔，用于连接顶层接地走线与底层接地平面。相比之下，JEDEC 高 K 近似布局具有相似的性能，它有两个过孔，将顶部接地走线连接到内部层。尽管 JEDEC 高 K 近似布局中增加了铜箔，但额外增加一个散热过孔所带来的热传导能力提升有限，不足以使 θ_{JA} 获得显著改善。

与 JEDEC 高 K 近似板相比，热增强型和热饱和型板的 θ_{JA} 减少了约 33%，明显大于 TPS745 和 TPS7B82-Q1 在相同对比条件下的降幅。这是因为 SOT-23 封装中没有散热焊盘。热增强型和热饱和型布局是唯一在顶层包含铜平面的布局。该封装因无散热焊盘，大部分热量需通过顶层散发。因此，在顶层设置铜平面的散热效果更为显著。此外，热增强型封装和热饱和封装中增设的散热过孔，是热量传导至内层与底层的唯一途径。相比之下，TPS745 和 TPS7B82-Q1 的布局在散热焊盘正下方已设有散热过孔，因此额外增加散热过孔的效果会有所减弱。

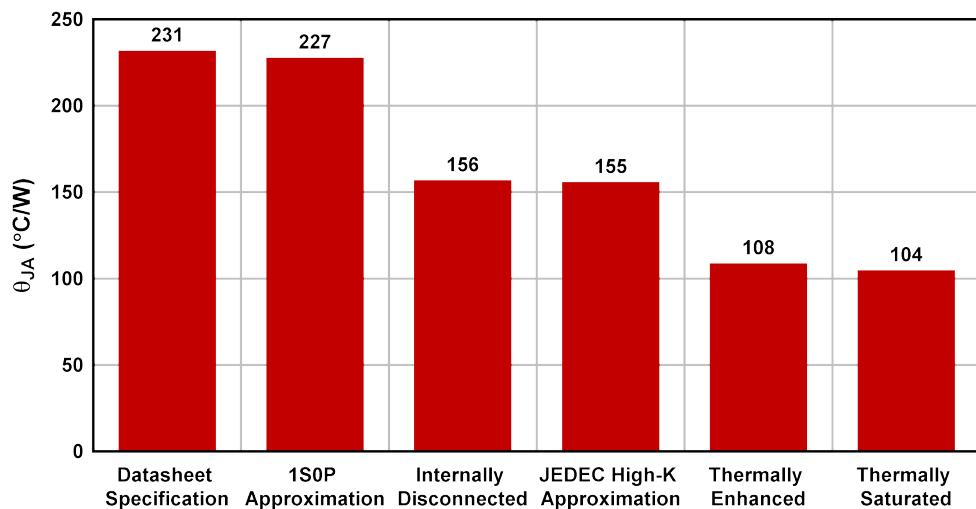
图 3-4. TLV755P (SOT-23) θ_{JA} 与电路板布局间的关系

图 3-5 比较了 PCB 布局与封装类型的有效性。有效性以 θ_{JA} 的降低百分比来衡量。由方程式 3 的计算结果可知，根据封装类型的不同，高效热布局可使数据手册中规定的 θ_{JA} 降低 32% 至 55%。数据表中规定的 θ_{JA} 可用于对 LDO 的结温升高值进行保守估算。但参考方程式 2 可知，使用高效散热的布局后，结温的实际升高值可降低

32% 至 55%。考虑到这一改善效果，设计时可选择更高的工作环境温度、更高的功耗水平或二者的某种组合。通过方程式 4 与 1SOP 近似布局进行比较，可以看出采用高效散热型布局的重要性。与这种最差情况布局相比，高效热布局的实测 θ_{JA} 降至前者的 1/4。

$$\text{Reduction of } \theta_{JA} \text{ compared to Datasheet Specification} = \left(1 - \frac{\theta_{JA,\text{saturated}}}{\theta_{JA,\text{datasheet}}} \right) \times 100 \quad (3)$$

$$\text{Reduction of } \theta_{JA} \text{ compared to 1SOP Approximation} = \left(1 - \frac{\theta_{JA,\text{saturated}}}{\theta_{JA,1SOP}} \right) \times 100 \quad (4)$$

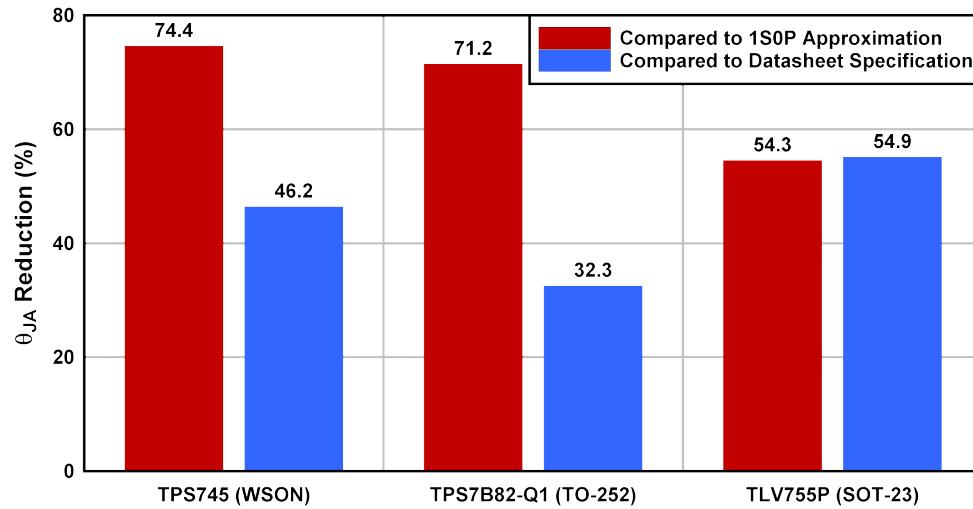


图 3-5. 各器件的 θ_{JA} 降低情况

图 3-6 使用方程式 5 对图 3-2、图 3-3 和图 3-4 中的结果相对于数据手册规格进行了归一化处理。

$$\theta_{JA,\text{normalized}} = \frac{\theta_{JA,\text{measured}}}{\theta_{JA,\text{datasheet}}} \quad (5)$$

该图汇总了三种封装的采集数据，以阐明本研究的重要结论。首先，PCB 铜含量与 θ_{JA} 之间呈反比关系，且随着铜含量增加，这种反比关系会逐渐趋于饱和。无论采用何种封装，均可观察到这一关系。如 1SOP 近似布局与内部断开布局之间的显著下降所示，这表明铜箔无需与 LDO 直接连接，即可改善热性能。在器件周围增设散热过孔可为 LDO 产生的热量提供更多传导至内层与底层的路径，从而同样能改善热性能。对于 SOT-23 这类无专用散热焊盘的封装，此类散热过孔尤为重要。然而，从热增强型布局和热饱和型布局之间改善幅度极小可看出，额外散热过孔对 θ_{JA} 的改善会趋于饱和。

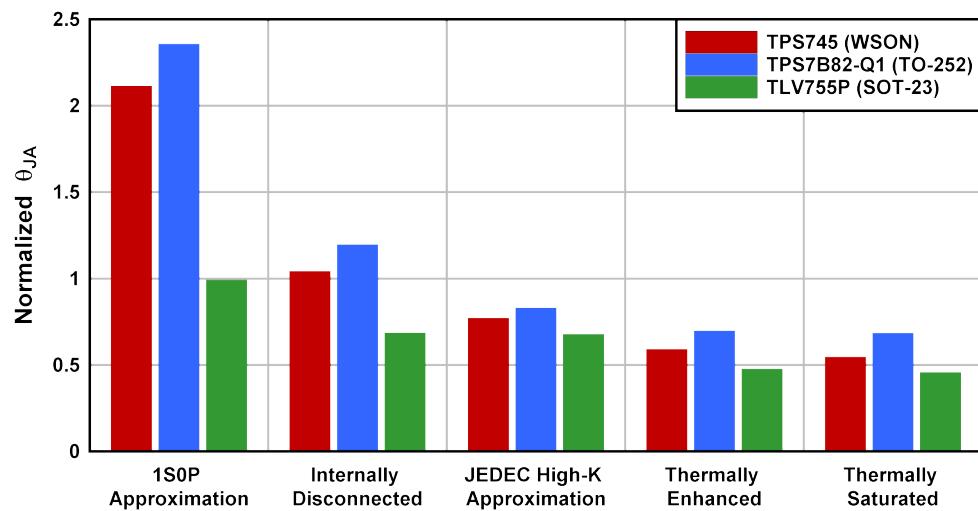


图 3-6. 每个器件的归一化 θ_{JA} 与电路板布局间的关系

4 结语

LDO 在结至环境热阻 θ_{JA} 方面的热性能在很大程度上取决于 PCB 设计。但 PCB 对热性能的影响最终受限于 LDO 的封装类型。具有散热焊盘的封装（例如 WSON 和 TO-252 封装）具有更强的散热能力，因此与最坏情况的 1SOP 近似布局相比，其 θ_{JA} 整体降幅更大，分别达到 74% 和 71%。SOT-23 封装体积更小，但仍有 54% 的显著降低。图 3-5 表明，与数据手册规格相比，采用热优化布局可使 θ_{JA} 降低 32% 至 55%。该结果表明，使用数据表中规定的 θ_{JA} 进行热性能计算，得到的是偏保守的热性能估算值。但设计人员需注意，高效热布局可支持更高的工作环境温度、更高的功耗水平，或同时兼具这两项优势。

图 3-6 表明，无论采用何种封装，随着 PCB 铜含量增加，热性能提升会逐渐趋于饱和。对于这三款封装，热增强型布局的铜面积约为热饱和型布局的一半，但其 θ_{JA} 的差异在 8% 以内。同样，通过增加散热过孔实现的热性能提升也会趋于饱和。从热饱和型布局的结果可知，在 PCB 上额外增加过孔所带来的好处很小。采用类似热增强型布局的设计，即可实现足够的热性能。对于更紧凑的设计，可参见图 3-4，该图展示了 TLV755P (SOT-23) 的测量结果。这些结果表明，需最大限度增加顶层与底层的铜含量，因为这两层不受额外 PCB 材料包裹，是散热效率最高的区域。只需在器件周围增设散热过孔，即可将 LDO 产生的热量有效传导至其他铜层。在使用没有散热焊盘的封装（例如 SOT-23 封装）进行设计时，这些过孔尤为重要。在这些情况下，也可将散热过孔直接设置在器件正下方，即热量产生最多的区域。根据 <https://www.jedec.org/system/files/docs/JESD51-9.pdf>，带有散热焊盘的封装需在散热焊盘区域设置尽可能多的散热过孔。最后，所有内部断开布局图 3-6 的数据表明，如果可能，必须在内层上加入额外的覆铜，即便这些铜箔未直接与 LDO 相连，也能对热性能产生积极影响。

5 未来研究方向

未来研究可围绕以下几个方向展开。研究上述布局或类似布局对超小尺寸（小于 1mm^2 ）封装（例如传统上热性能较差的 DSBGA 和 X2SON）热性能的影响。由于小尺寸封装本身散热能力较弱，与 WSON、TO-252 及 SOT-23 封装相比，PCB 布局对其热性能的影响可能会更小。本研究另一个更复杂的延伸方向是：构建一个公式或品质因数 (FOM)，将连接铜面积、非连接铜面积、这些区域相对于电路板层叠的位置、散热过孔数量等因素纳入其中。该 FOM 将与电路板等效热阻抗相关联，可用于为特定布局的预期结到环境热阻 θ_{JA} 提供更具针对性的数值。

6 参考资料

1. 《采用小型 SMD 封装的 LDO 热性能》应用报告
2. 《AN-1520 外露焊盘封装实现最佳热阻的电路板布局布线指南》应用报告
3. 《半导体和 IC 封装热指标》
4. 《含引线的表面贴装封装对应的低效导热性测试板》
5. 《含引线的表面贴装封装对应的高效导热性测试板》
6. 《空间阵列表面贴装封装散热测量测试板》
7. 《现场测量 LDO 的热阻抗》应用报告

7 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (February 2019) to Revision A (September 2025)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	2

A 热测试电路板布局

A.1 TPS745 (WSON) 图

A.1.1 1S0P 近似布局图

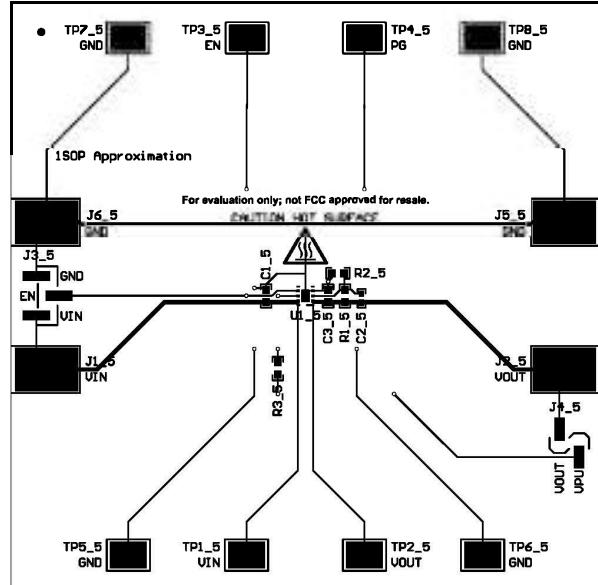


图 A-1. TPS745 (WSON) 1S0P 近似布局顶层

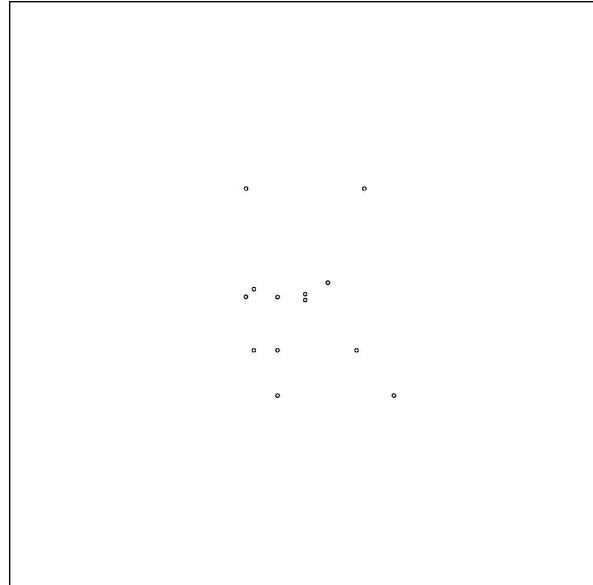


图 A-2. TPS745 (WSON) 1S0P 近似布局内层 1

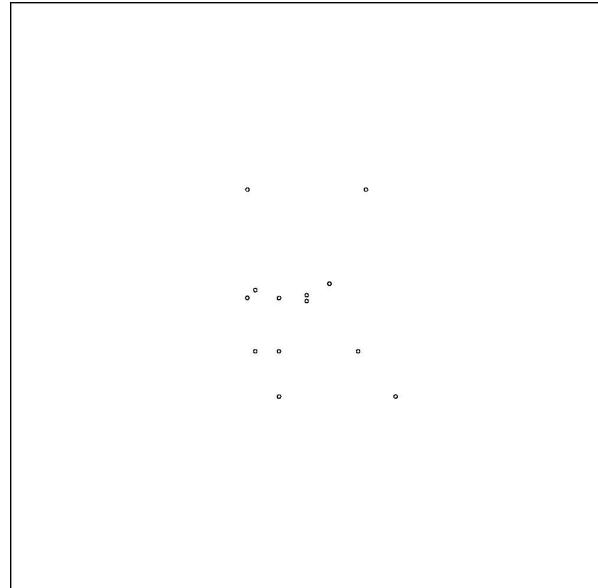


图 A-3. TPS745 (WSON) 1S0P 近似布局内层 2

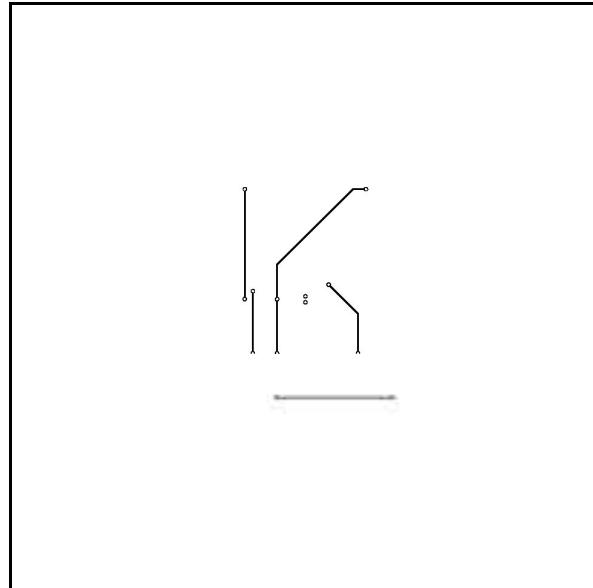
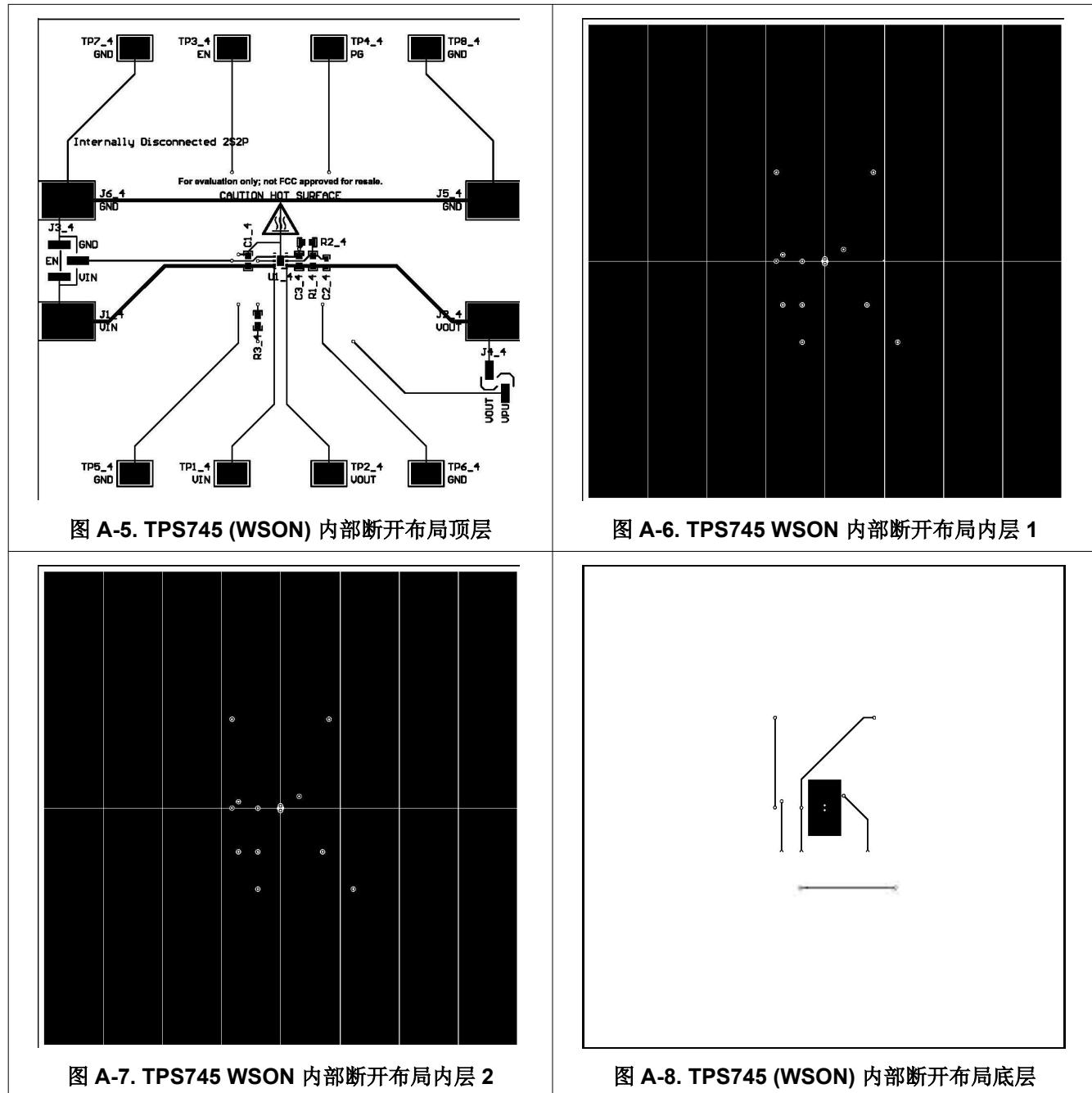


图 A-4. TPS745 (WSON) 1S0P 近似布局底层

A.1.2 内部断开布局图


A.1.3 JEDEC 高 K 近似布局图

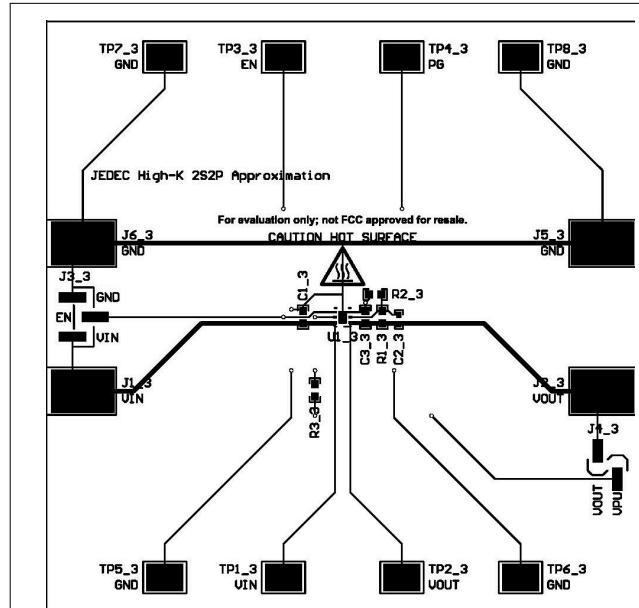


图 A-9. TPS745 (WSON) JEDEC 高 K 近似布局顶层

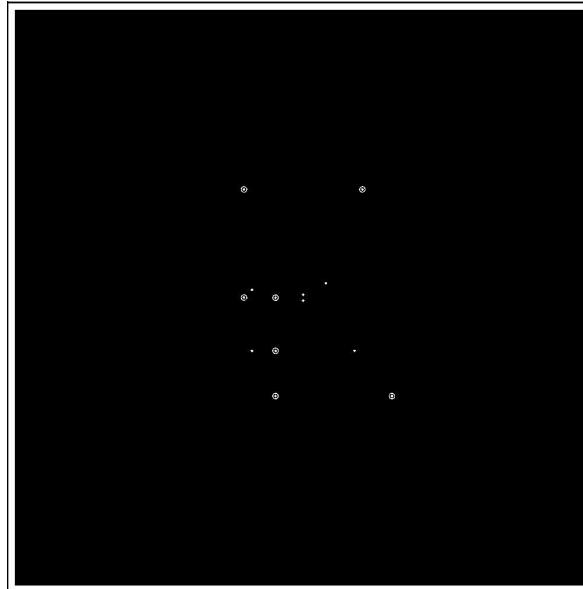


图 A-10. TPS745 (WSON) JEDEC 高 K 近似布局内层 1

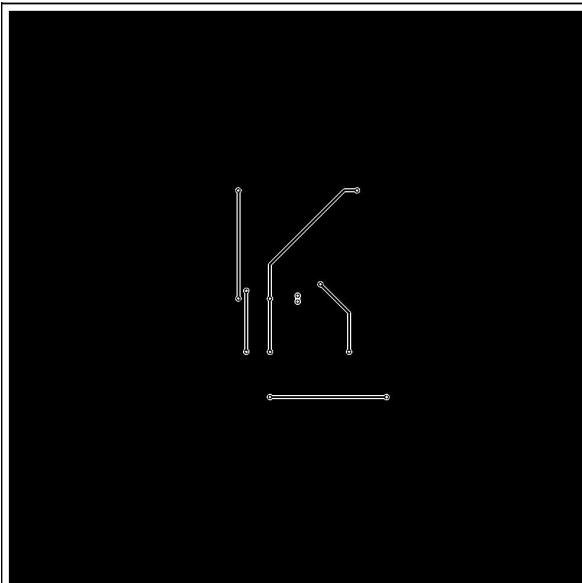


图 A-11. TPS745 (WSON) JEDEC 高 K 近似布局内层
2

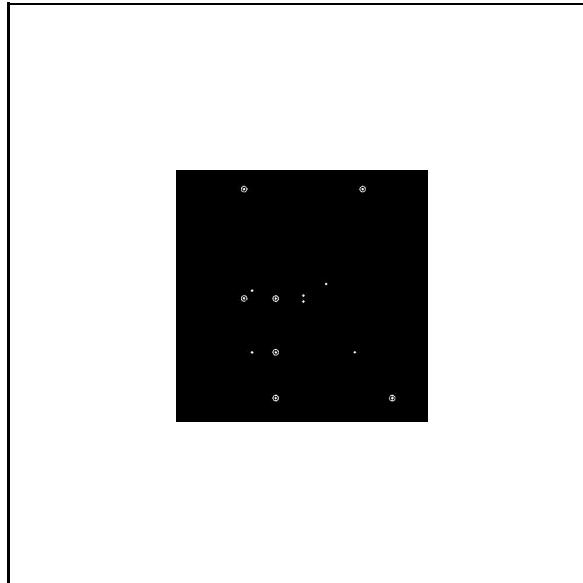
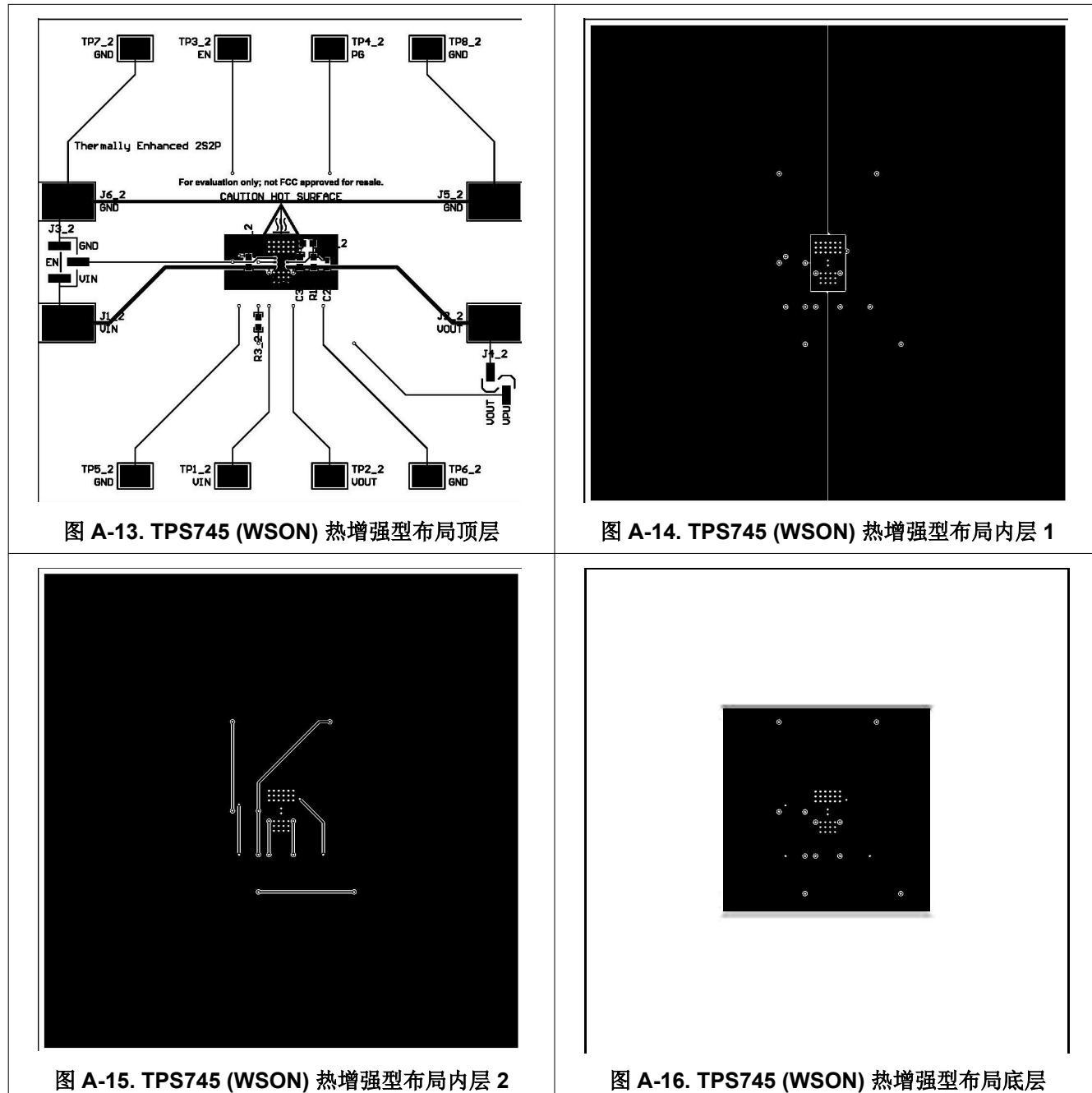


图 A-12. TPS745 (WSON) JEDEC 高 K 近似布局底层

A.1.4 热增强型布局图


A.1.5 热饱和型布局图

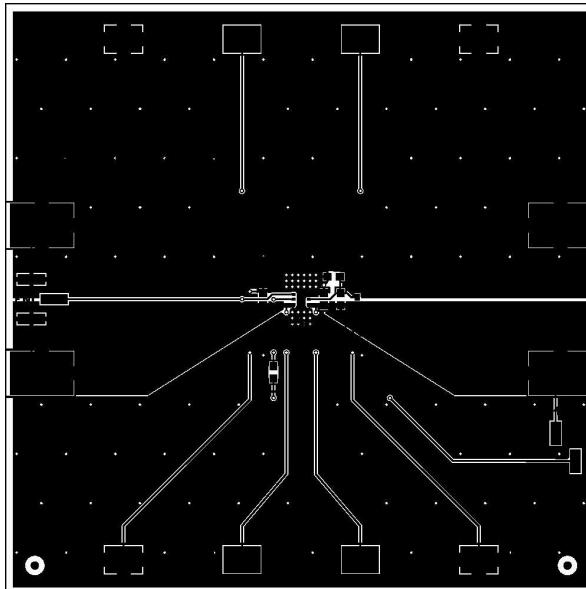


图 A-17. TPS745 (WSON) 热饱和型布局顶层

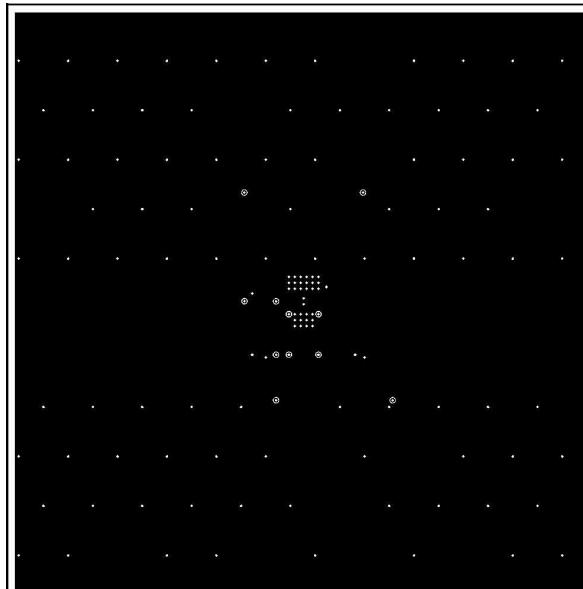


图 A-18. TPS745 (WSON) 热饱和型布局内层 1

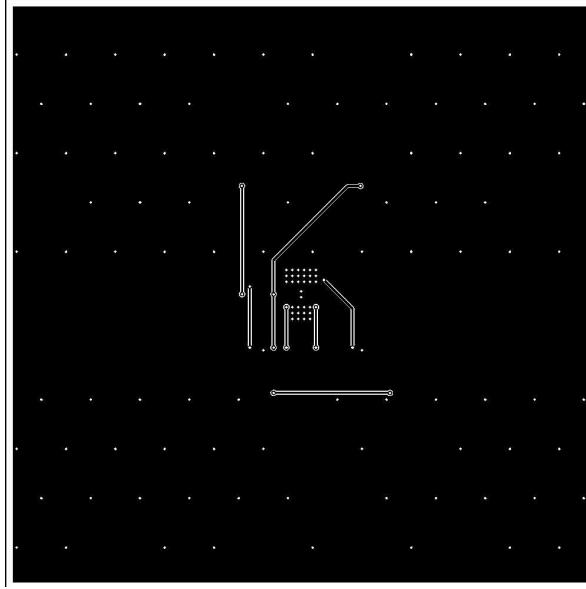


图 A-19. TPS745 (WSON) 热饱和型布局内层 2

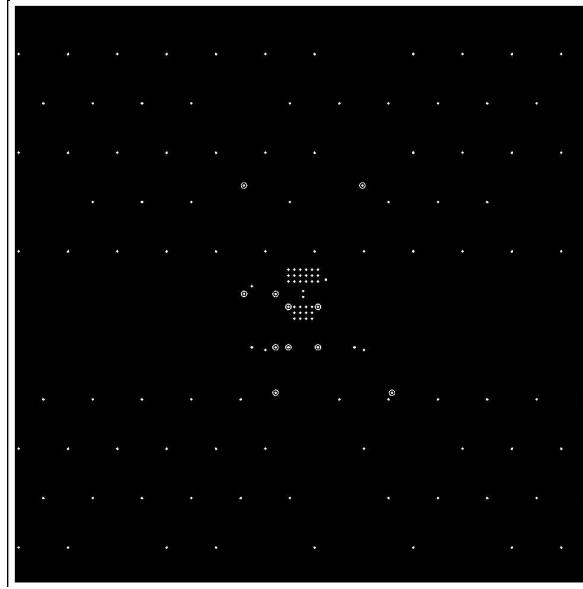
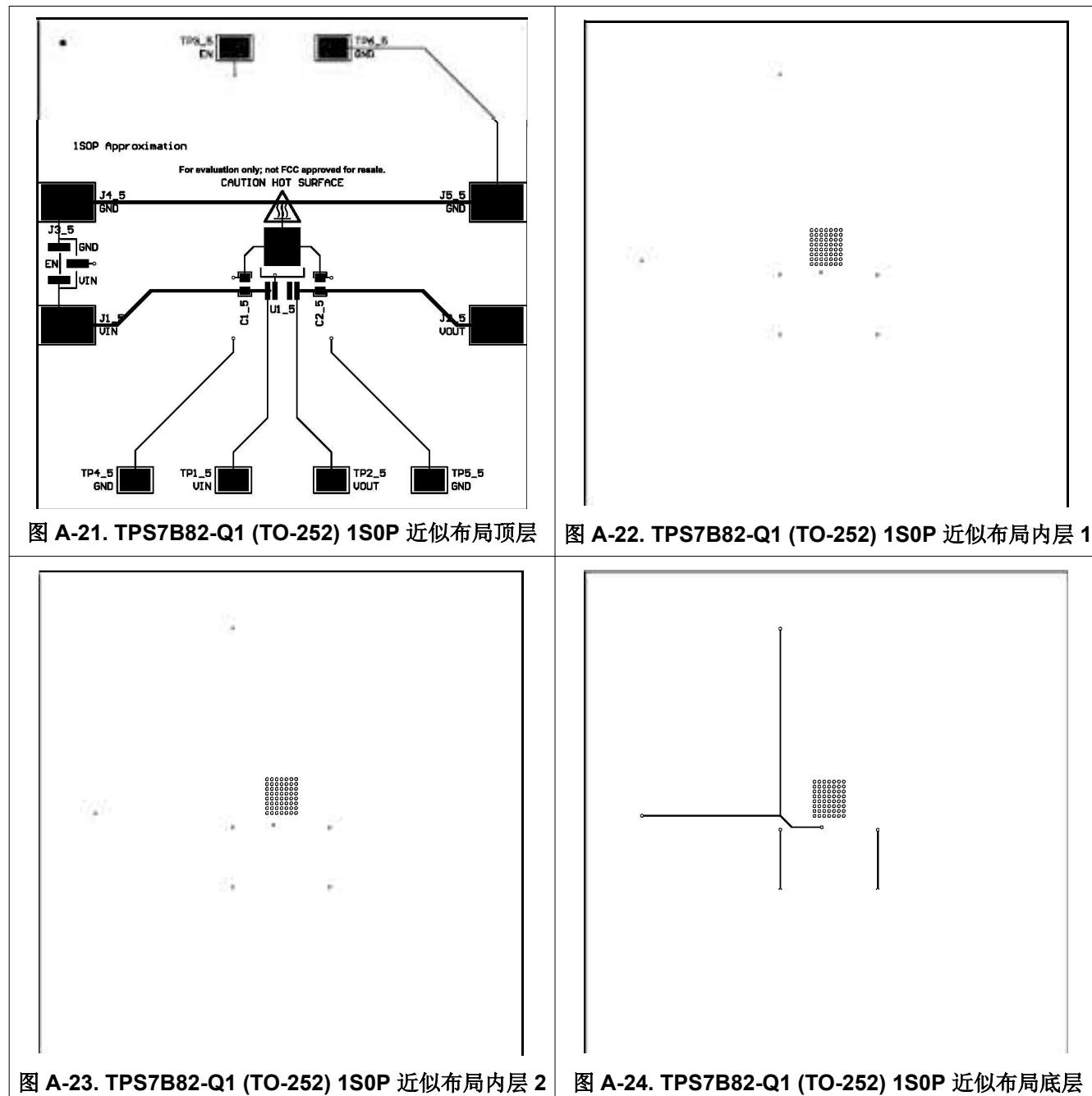


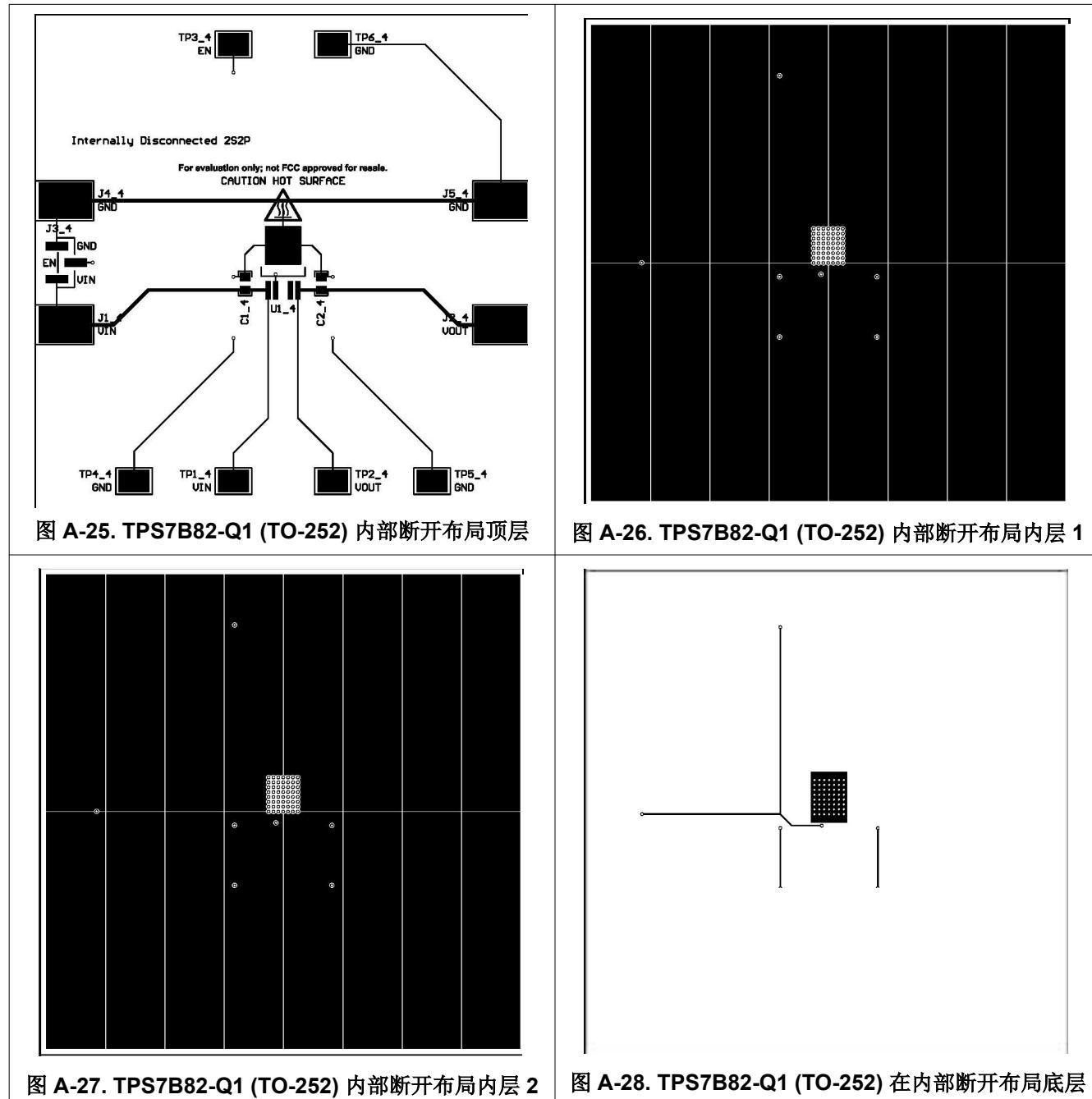
图 A-20. TPS745 (WSON) 热饱和型布局底层

A.2 TPS7B82-Q1 (TO-252) 图

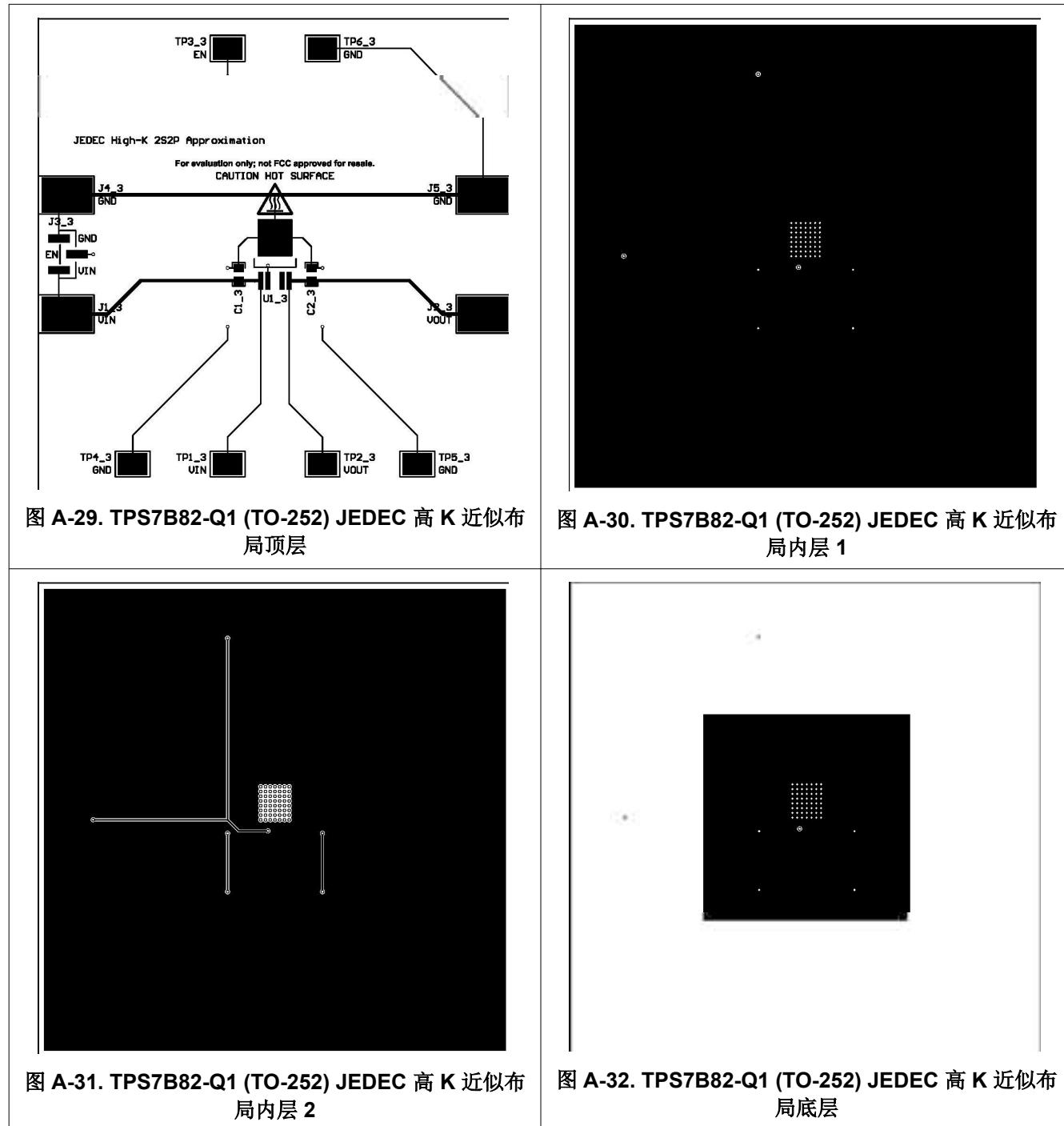
A.2.1 1SOP 近似布局图



A.2.2 内部断开布局图



A.2.3 JEDEC 高 K 近似布局图



A.2.4 热增强型布局图

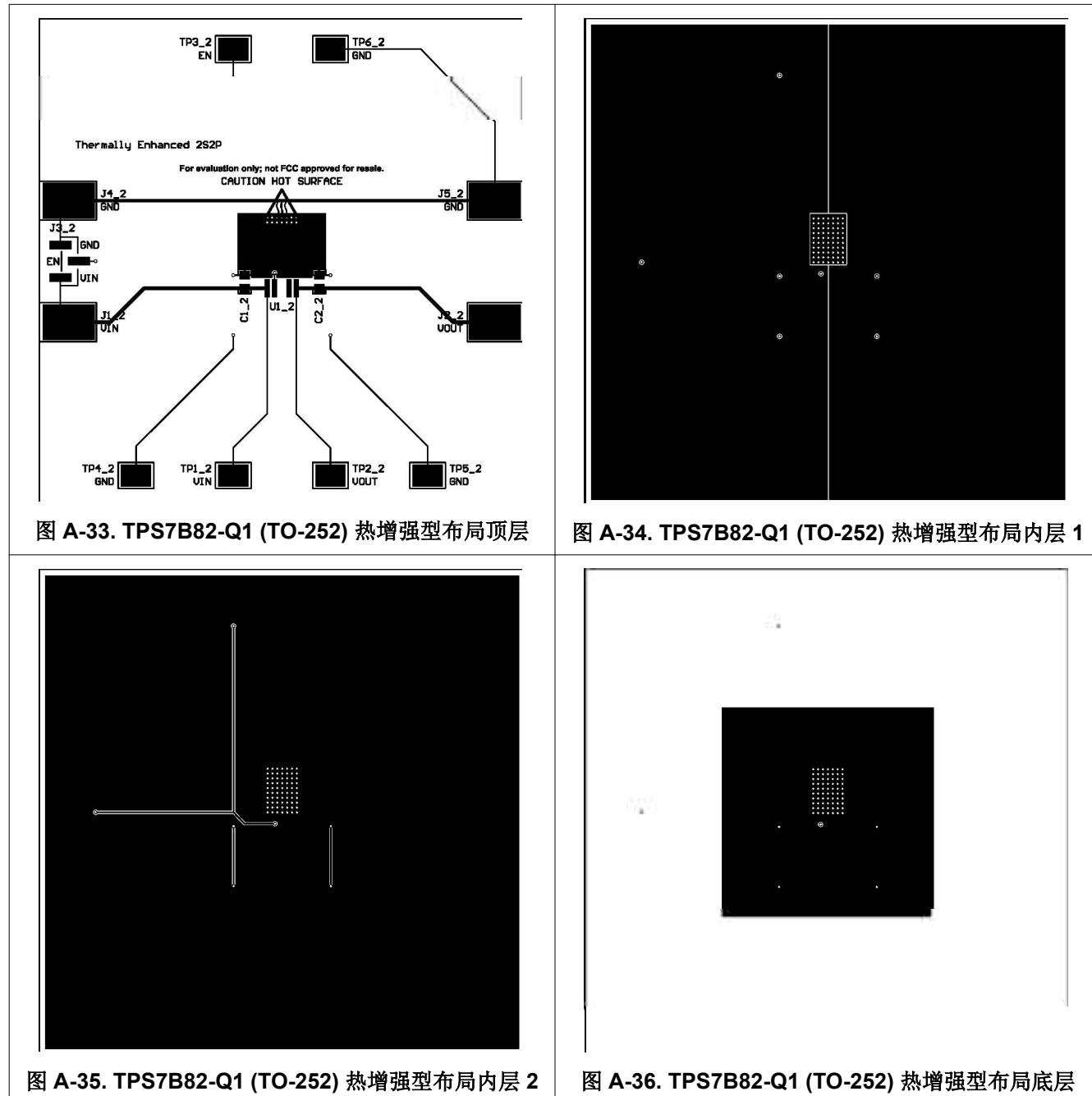


图 A-33. TPS7B82-Q1 (TO-252) 热增强型布局顶层

图 A-34. TPS7B82-Q1 (TO-252) 热增强型布局内层 1

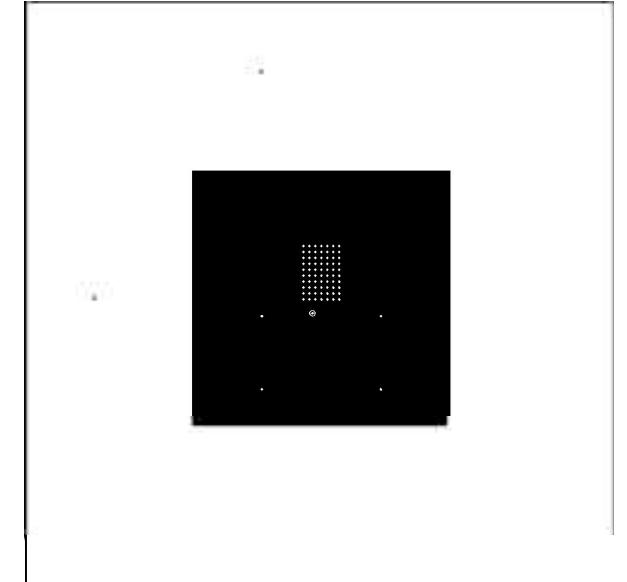


图 A-35. TPS7B82-Q1 (TO-252) 热增强型布局内层 2

图 A-36. TPS7B82-Q1 (TO-252) 热增强型布局底层

A.2.5 热饱和型布局图

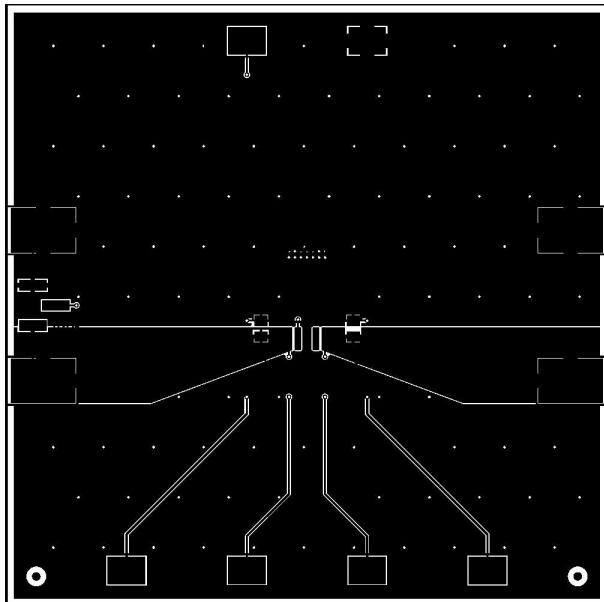


图 A-37. TPS7B82-Q1 (TO-252) 热饱和型布局顶层

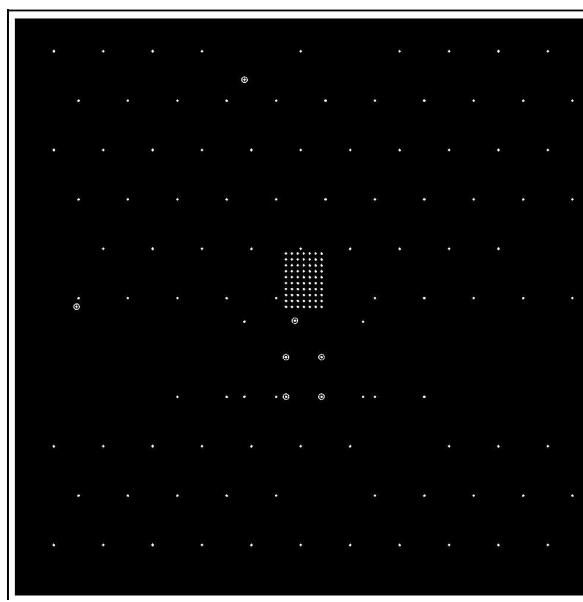


图 A-38. TPS7B82-Q1 (TO-252) 热饱和型布局内层 1

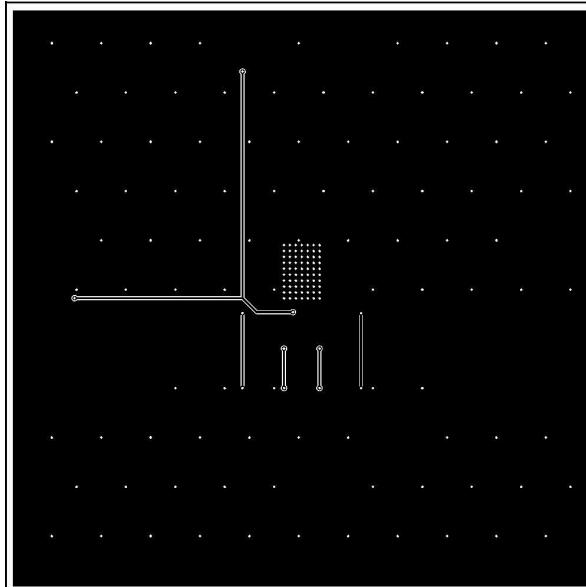


图 A-39. TPS7B82-Q1 (TO-252) 热饱和型布局内层 2

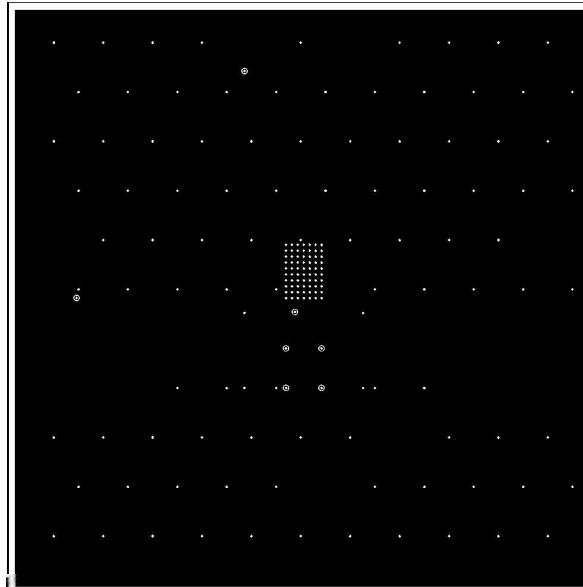


图 A-40. TPS7B82-Q1 (TO-252) 热饱和型布局底层

A.3 TLV755P (SOT-23) 图

A.3.1 1SOP 近似布局图

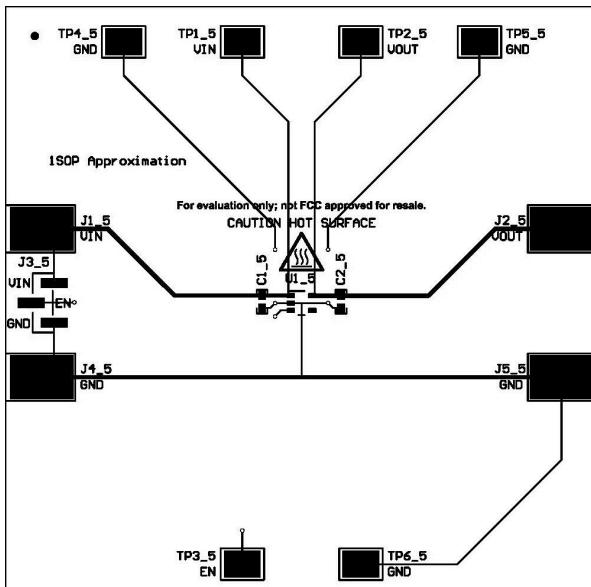


图 A-41. TLV755P (SOT-23) 1SOP 近似布局顶层

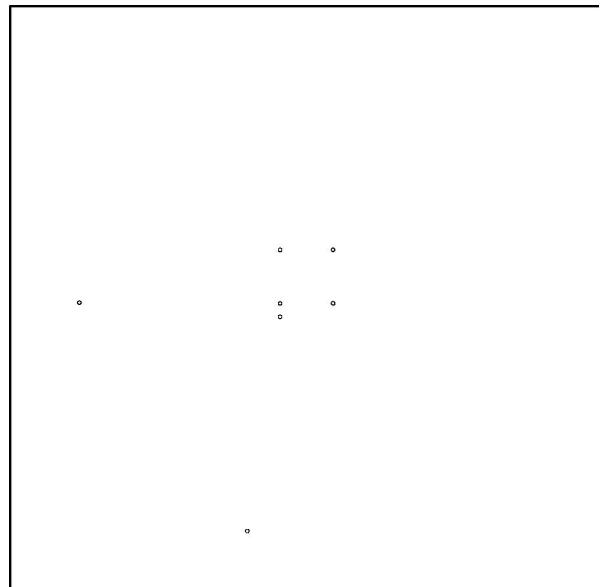


图 A-42. TLV755P (SOT-23) 1SOP 近似布局内层 1

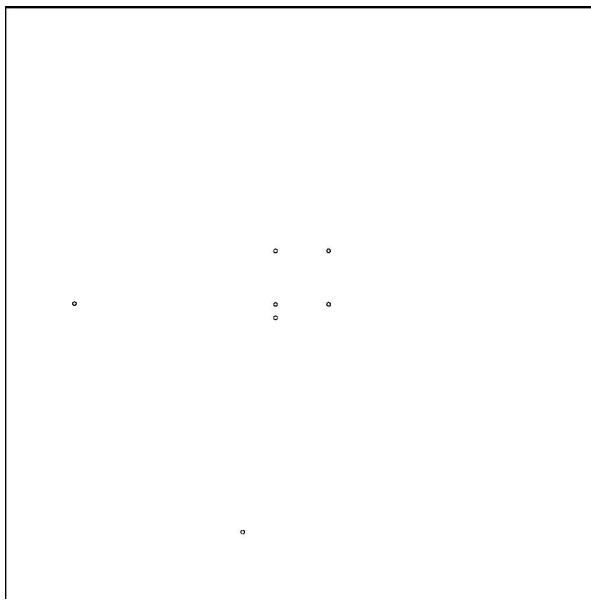


图 A-43. TLV755P (SOT-23) 1SOP 近似布局内层 2

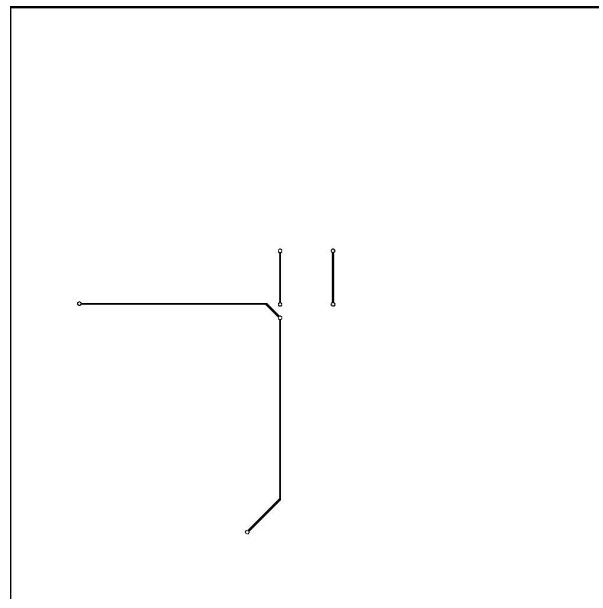


图 A-44. TLV755P (SOT-23) 1SOP 近似布局底层

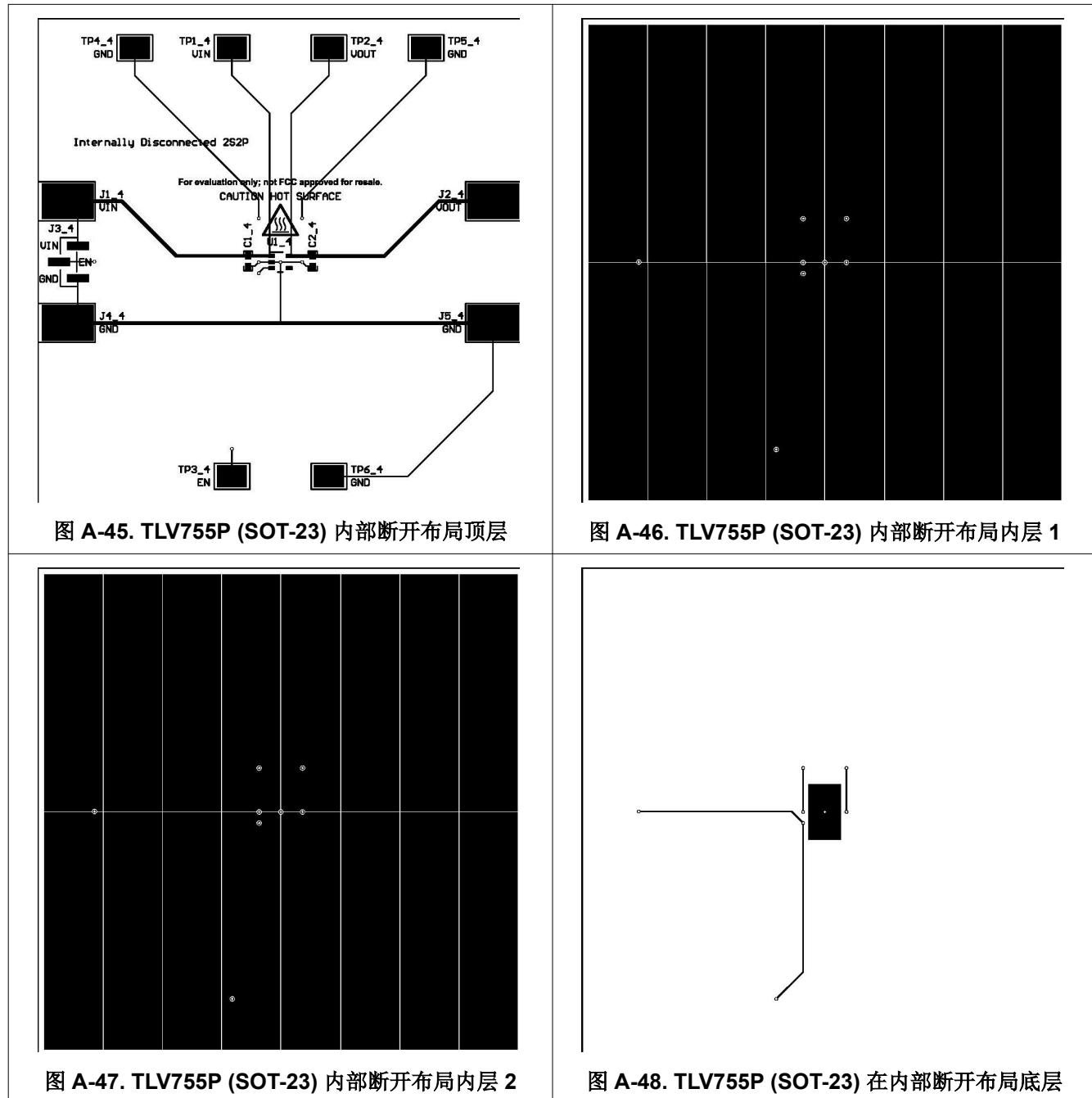
A.3.2 内部断开布局图


图 A-45. TLV755P (SOT-23) 内部断开布局顶层

图 A-46. TLV755P (SOT-23) 内部断开布局内层 1

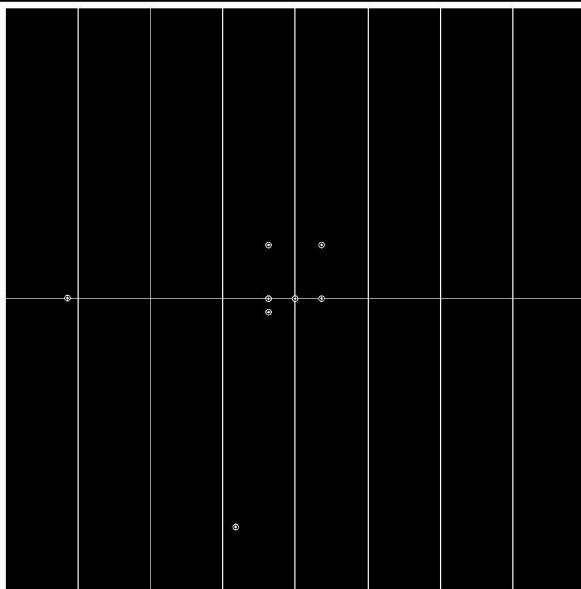


图 A-47. TLV755P (SOT-23) 内部断开布局内层 2

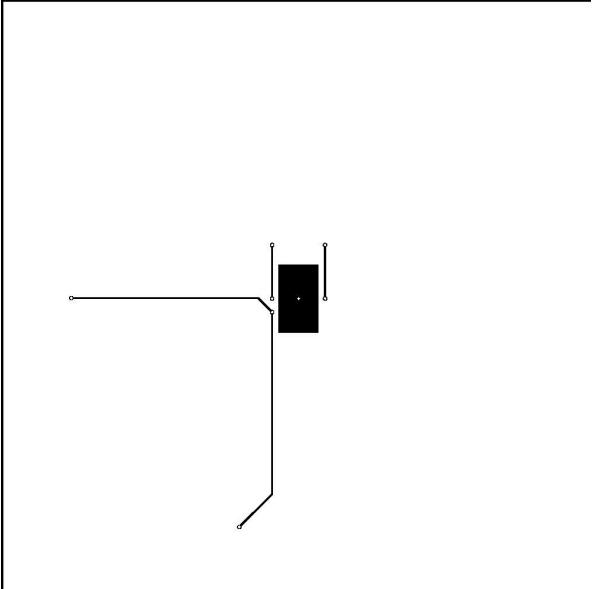


图 A-48. TLV755P (SOT-23) 在内部断开布局底层

A.3.3 JEDEC 高 K 近似布局图

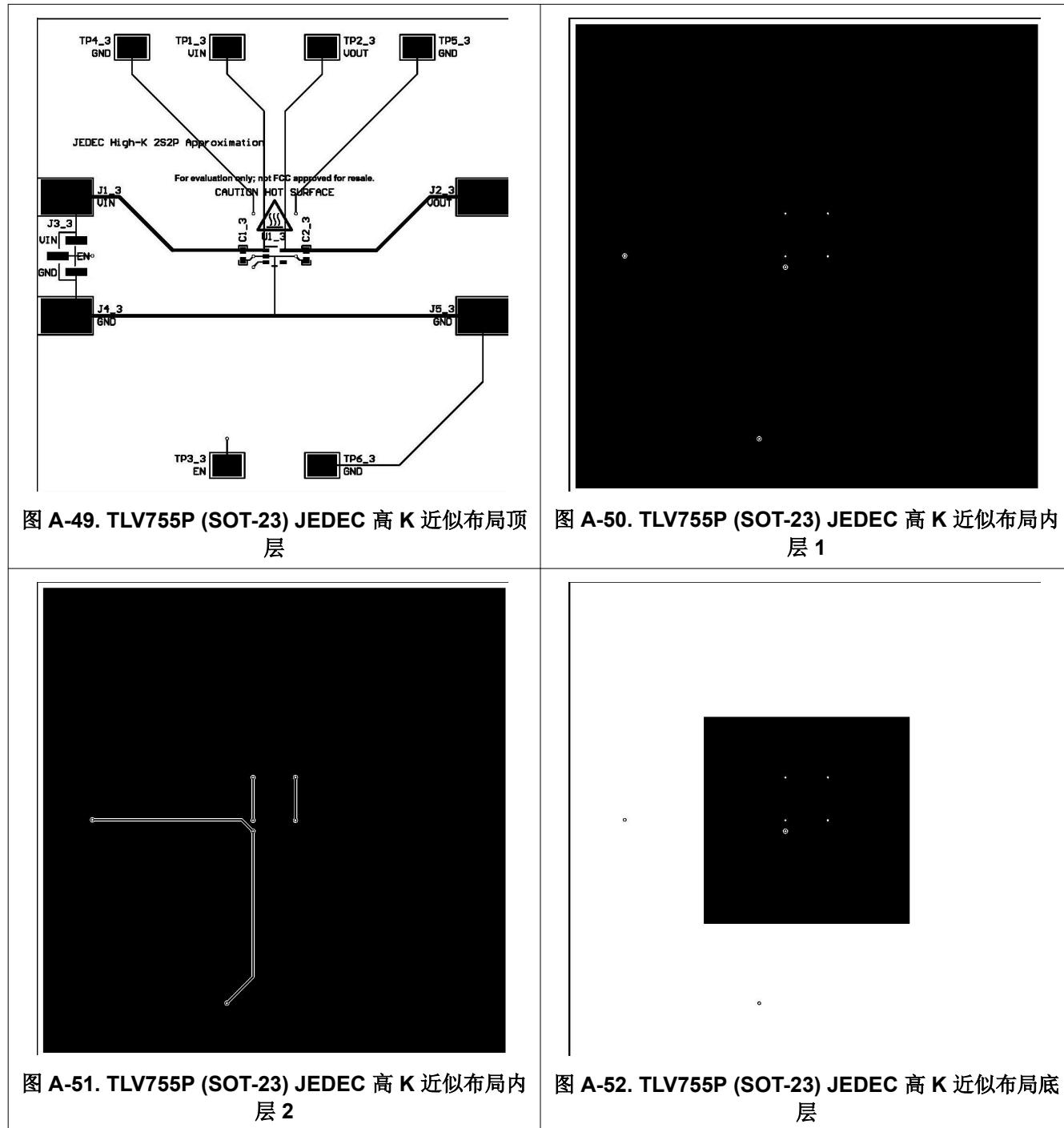


图 A-49. TLV755P (SOT-23) JEDEC 高 K 近似布局顶层

图 A-50. TLV755P (SOT-23) JEDEC 高 K 近似布局内层 1

图 A-51. TLV755P (SOT-23) JEDEC 高 K 近似布局内层 2

图 A-52. TLV755P (SOT-23) JEDEC 高 K 近似布局底层

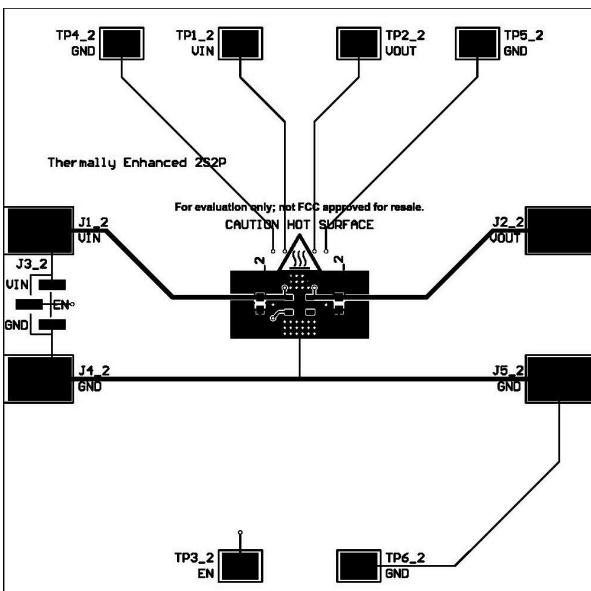
A.3.4 热增强型图


图 A-53. TLV755P (SOT-23) 热增强型布局顶层

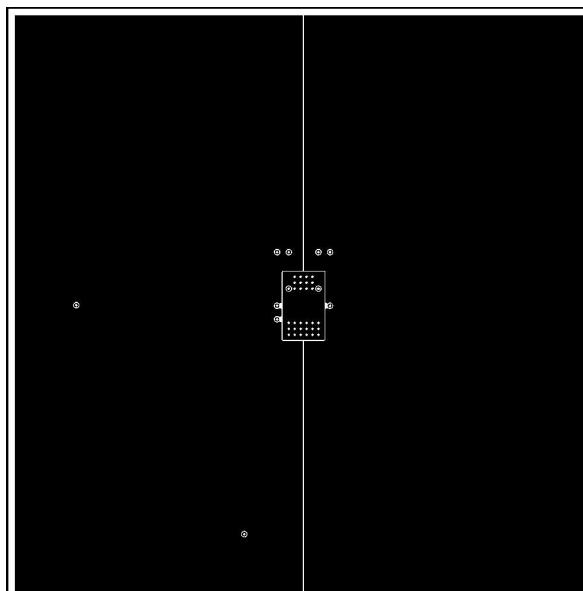


图 A-54. TLV755P (SOT-23) 热增强型布局内层 1

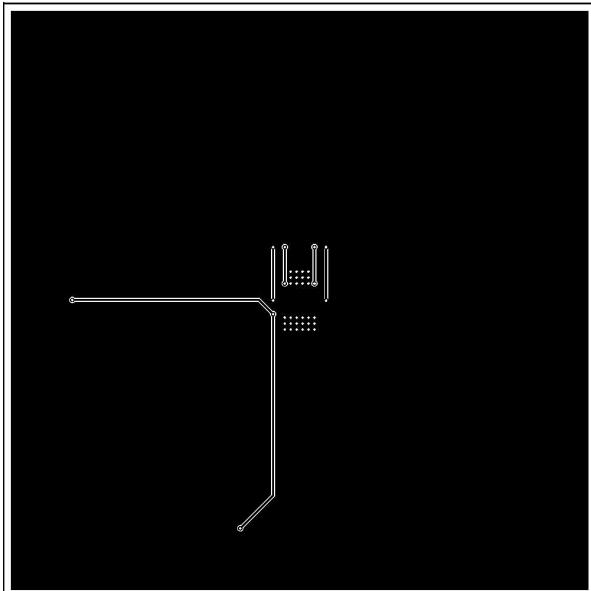


图 A-55. TLV755P (SOT-23) 热增强型布局内层 2

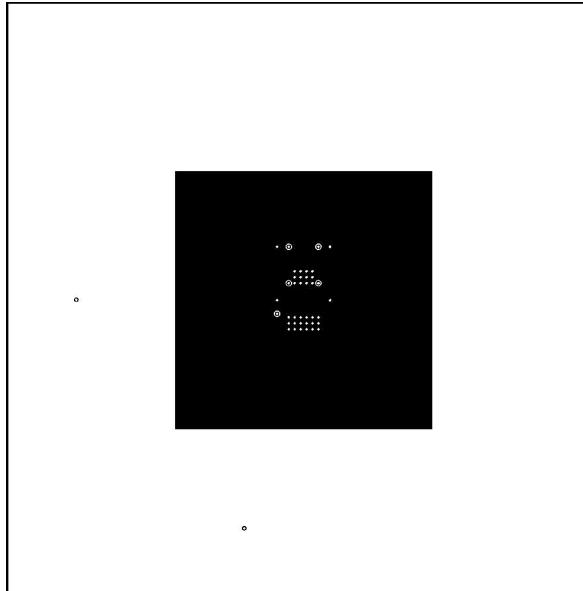


图 A-56. TLV755P (SOT-23) 热增强型布局底层

A.3.5 热饱和型布局图

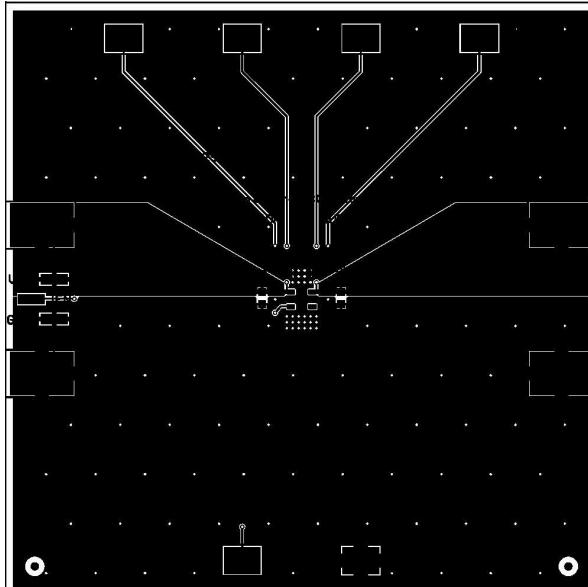


图 A-57. TLV755P (SOT-23) 热饱和型布局顶层

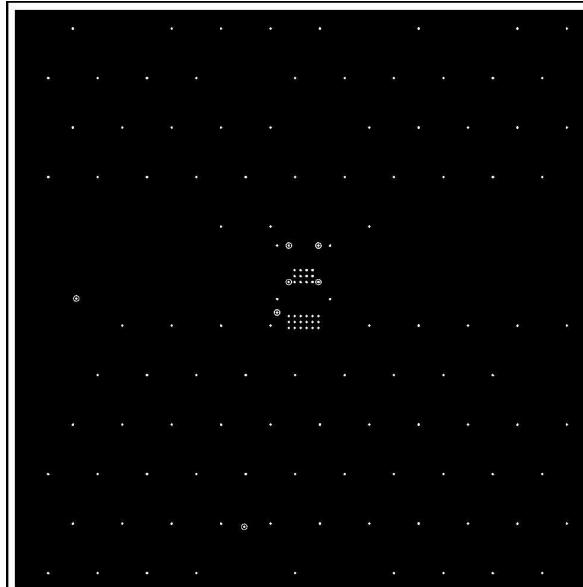


图 A-58. TLV755P (SOT-23) 热饱和型布局内层 1

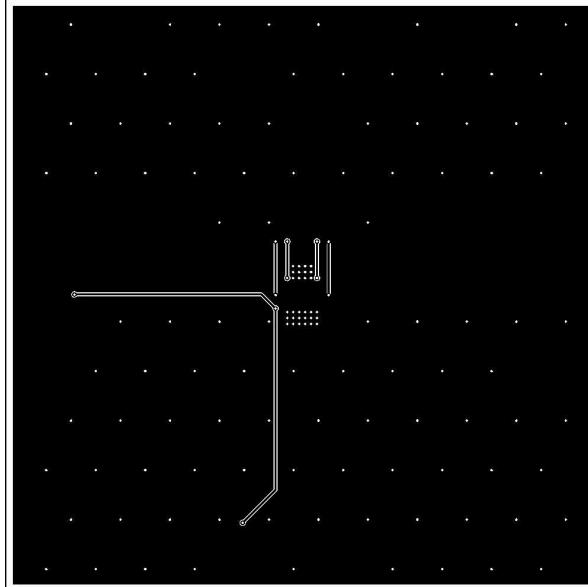


图 A-59. TLV755P (SOT-23) 热饱和型布局内层 2

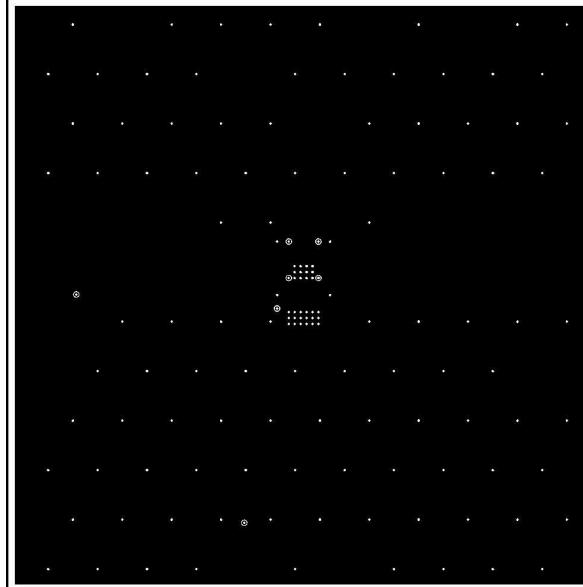


图 A-60. TLV755P (SOT-23) 热饱和型布局底层

B 热测试结果

B.1 热性能数据

表 B-1. 最高环境温度与功率耗散间的关系

电路板	TPS745 (WSON)		TPS7B82-Q1 (TO-252)		TLV755P (SOT-23)	
	P _D (W)	T _{A,max} (°C)	P _D (W)	T _{A,max} (°C)	P _D (W)	T _{A,max} (°C)
1SOP 近似布局	0.00	175	0.00	182	0.00	165
	0.26	130	0.51	135	0.20	124
	0.51	88	1.00	90	0.39	80
	0.90	23	1.70	27	0.62	24
内部断开布局	0.00	178	0.00	178	0.00	164
	0.59	129	1.00	134	0.25	126
	1.14	83	1.95	88	0.49	88
JEDEC 高 K 近似布局	0.00	178	0.00	180	0.00	163
	0.74	130	1.53	133	0.27	122
	1.49	87	3.01	84	0.53	81
热增强型	0.00	179	0.00	178	0.00	166
	0.83	135	1.77	129	0.36	128
	1.73	98	3.51	84	0.69	91
热饱和型	0.00	177	0.00	177	0.00	164
	0.84	139	1.81	128	0.38	127
	1.64	106	3.62	82	0.76	85

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月